

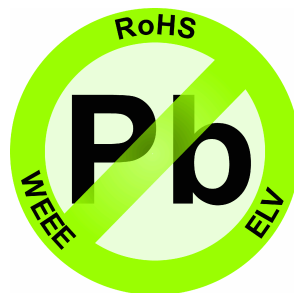
Case		3 x 3 x 1.8 (SO)	4.7 x 3.9 x 2.4 (SO)	8.5 x 6.6 x 3.2	8.5 x 6.6 x 3.2	Case	
Bridge rectifiers	Package	Micro-DIL	Mini-DIL	SO-DIL	DIL	Package	Voltage V_{RRM} [V]
Current		0.5 A	0.8 A	1 A	1 A	Current	
Standard recovery	80	MYS40	S40	B40S	B40D	Standard recovery	80
	160	MYS80	S80	B80S	B80D		160
	250	MYS125	S125	B125S	B125D		250
	600	MYS250	S250	B250S	B250D		600
	800	MYS380	S380	B380S	B380D		800
	1000		S500	B500S	B500D		1000
Fast recovery	80			B40FS	B40FD	Fast recovery	
	160			B80FS	B80FD		
	250			B125FS	B125FD		
	600			B250FS	B250FD		
	800			B380FS	B380FD		
Schottky Barrier	20			CS10S	CS10D	Schottky Barrier	20
	30						30
	40			CS20S	CS20D		40
	50						50
	60			CS30S	CS30D		60
	90			CS40S	CS40D		80
	100			CS50S	CS50D	100	

Environment friendly components

Since 2004, Diotec is offering lead free components according to EU directives "RoHS" (Reduction of Hazardous Substances), "WEEE" (Waste Electrical and Electronic Equipment) and "ELV" (End of Life Vehicles). Target of these directives is to either reduce or, wherever possible, avoid hazardous substances, like the lead (Pb) used in electronic components. For more information, please see our website:

<http://www.diotec.com/>

"Products" - "lead free products"



Umweltfreundliche Produkte

Seit 2004 bietet Diotec bleifreie Produkte gemäß den EU-Richtlinien "RoHS" (Reduction of Hazardous Substances), "WEEE" (Waste Electrical and Electronic Equipment) sowie "ELV" (End of Life Vehicles) an. Diese Richtlinien haben das Ziel, gefährliche Substanzen wie das in elektronischen Bauteilen verwendete Blei (Pb) zu reduzieren bzw. wo immer möglich zu vermeiden. Mehr Informationen im Internet:

<http://www.diotec.com/>

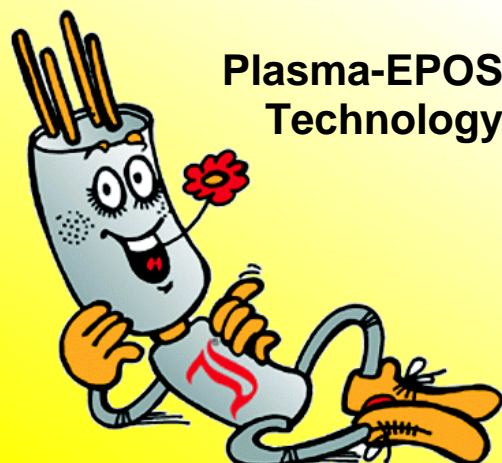
"Produkte" - "bleifreie Produkte"

Environment friendly production

Since 1997, Diotec produces semiconductor chips by the "Plasma-EPOS" process, developed by its own. In contrast to the normally used, aggressive acids for etching (= cleaning) of the silicon edges, etching and passivation is done under nearly vacuum conditions by means of a plasma process. A double passivation by Silicon Nitride (glass like, electrically insulating) and Polysiloxane (flexible, mechanically compensating) provides for a high reliability of the produced devices. For more information, please visit our website:

<http://www.diotec.com/>

"Profile" - "Company Profile"



Umweltfreundliche Produktion

Seit 1997 produziert Diotec Halbleiter-Chips mit dem selbst entwickelten Plasma-EPOS Verfahren. Dabei kommen nicht wie sonst üblich aggressive Säuren zum Ätzen (= Reinigen) der Silizium-Kanten zum Einsatz. Das Ätzen und Passivieren erfolgt nahezu im Vakuum durch ein Plasma-Verfahren. Eine doppelte Passivierung mit Siliziumnitrid (glasartig, elektrisch isolierend) sowie Polysiloxan (flexibel, mechanisch ausgleichend) sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit der produzierten Bauelemente. Mehr Informationen im Internet unter:

<http://www.diotec.com/>

"Profil" - "Firmenprofil"